

「先端加工フォーラム 2018」開催案内

主催：(公社)砥粒加工学会 北陸信越地区部会 共催：金沢工業大学 FMT 研究所

(公社)砥粒加工学会 北陸信越地区部会では、「先端加工フォーラム 2018」を下記のとおり開催いたします。「研磨」をキーワードに産学官のそれぞれのお立場からの講演(特別講演1件,技術講演4件)を予定しております。近年脚光を浴びる難加工 SiC 基板の「超精密研磨」をはじめ、「アシスト応用研磨」の研究最前線とその実際を知る絶好の機会を作りましたので、拡大技術交流会を含め多数の皆さまのご参加をお待ちしています。

日 時：平成30年5月11日(金) 13:00~19:00

開催場所：金沢工業大学 21号館 5階会議室
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1 TEL：076-248-1100
URL：http://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/ogigaoka.html
[交通] 金沢駅兼六園口8番乗り場 → 「金沢工業大学行き」(所要時間：約30分)
金沢駅からタクシーで約20分

内 容：

13:00~13:05 開会挨拶

(公社)砥粒加工学会 北陸信越地区部会長 西田 均(富山高等専門学校)

<特別講演>

13:05~13:55 SiC 半導体基板の加工技術(総論)

国立研究開発法人産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター
招聘研究員 河田研治 氏

<技術講演>

13:55~14:40 電界砥粒制御技術を用いた工具刃先研磨加工とその効果

愛知工業大学 工学部 機械学科 教授 田中 浩 氏

14:40~15:00 休憩

15:00~15:45 高圧カプラズマを用いた SiC 基板の高エネルギー無歪加工

大阪大学 大学院工学研究科 准教授 佐野泰久 氏

15:45~16:30 先端結晶材加工の技術動向と取組(仮題)

株式会社齊藤光学製作所 結晶事業部 事業部長 土田益広 氏

16:30~17:15 サブストレート加工への挑戦~研磨材料の需要拡大に向けて~

ニッタ・ハース株式会社 戦略マーケティング部 事業開発グループ マネージャー 羽場真一 氏

17:15~17:20 閉会挨拶

(公社)砥粒加工学会 副会長・北陸信越地区部会 事務局 諏訪部 仁(金沢工業大学)

17:40~19:00 拡大技術交流会

参加費：講演会・・・一般5,000円,学生無料,拡大技術交流会・・・一般3,000円,学生1,500円。当日徴収致します。

参加申込締切：平成30年4月20日(金)

参加申込先並びに問合せ先：金沢工業大学 工学部 機械工学科 精密工学(畝田)研究室 竹澤瑛里子
TEL：076-248-1100 FAX：076-274-7072 E-mail：unc-asst@neptune.kanazawa-it.ac.jp

(公社)砥粒加工学会 北陸信越地区部会「先端加工フォーラム 2018」参加申込書

氏名			
勤務先・所属			
参加内容 (参加されるものに○を付けて下さい)	研究会		拡大技術交流会
連絡先	住所		
	TEL	FAX	
	E-mail		
その他 連絡事項			

【上記項目をメール文面に直接書き込んで、お申し込みください】

→メール件名は「先端加工フォーラム 2018 参加申込書」としてください